TEXAS INSTRUMENTS
DS90UH983-Q1
ZHCSV19 – FEBRUARY 2024

DS90UH983-Q1 支持 HDCP 的 4K DisplayPort/eDP 转 FPD-Link IV 桥接串行器

1 特性

- DisplayPort 接收器
  - 兼容 DP/eDP v1.4
  - 支持数据通道交换和极性反转
  - HBR3/HBR2/HBR/RBR 链路比特率
  - 主链路：1、2 或 4 通道
  - 每通道高达 8.1Gbps
  - 辅助通道 1Mbps
  - 热插拔检测 (HPD)
  - 多显示器 (MST) 和 SST 支持
  - 支持对称和非对称 MST
  - 菊花链连接和分离
  - 超级帧解包功能
  - 适用于 4K (60Hz) 视频分辨率
- FPD-Link IV 接口
  - 支持每通道 13.5/12.528/10.8/6.75/3.375Gbps；双通道高达 27Gbps
  - 同轴/STP 互连支持
  - 端口拆分，以启用 Y 型电缆接口
  - 针对不同的 FPD 通道进行基于 MST 和超级帧的数据分离
- 超低延迟控制通道
  - 三个高达 1MHz 快速+ 模式 I^2C（本地总线访问高达 3.4MHz）
  - 高速 GPIO
- 向后兼容性
  - IVI 94x 和 92x 产品系列
- 安全和诊断
  - 适用于 FPD-Link III、具有片上密钥的集成 HDCP v1.4
  - 链路诊断
  - 电压和温度监测
  - 线路故障检测
  - BIST 和图形生成
  - CRC 和错误诊断
  - 针对控制位的 ECC 纠错
  - 冗余副本模式
- 高级链路稳定性和 EMC 控制
  - 展频时钟 (SSC) 输入支持
  - 展频时钟生成 (SSCG)
  - 数据换序
- 低功耗操作
  - 1.8V 和 1.15V 双电源供电
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
  - AEC-Q 等级 2，–40°C 至 105°C
  - 具有可湿性侧面的 64 引脚 9mm x 9mm QFN 封装
  - 符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD 标准

2 应用

- 汽车显示器：
  - 中央信息显示屏 (CID)
  - 后座娱乐系统 (RSE)
  - 数字仪表组
  - 音响主机和 HMI 模块
  - 抬头显示 (HUD)
  - 后视显示器和侧后视镜显示器

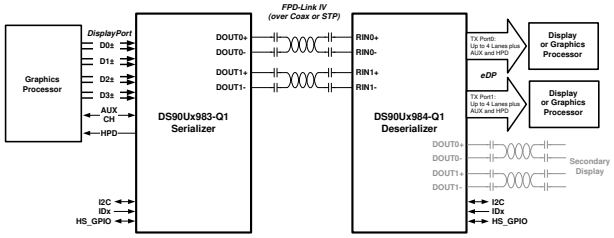
3 说明

DS90UH983-Q1 是一款 DisplayPort/eDP 转 FPD-Link III/FPD-Link IV 桥接器件。该芯片组与 FPD-Link IV 解串器配合使用，可通过低成本 50Ω 同轴电缆或 STP 电缆提供高速串行化接口。DS90UH983-Q1 是一款 VESA DP 标准 v1.4 兼容器件，支持 MST、HBR3、和超级帧格式等高级功能。该器件能够支持高达 4K 视频分辨率和 30 位颜色。8b10b 编码 DP 数据被串行化为 FPD-Link IV 接口输出。FPD-Link IV 接口支持通过单通道或双通道进行视频和音频数据传输和全双工控制，包括 I^2C 和 GPIO 数据。通过 FPD-Link IV 通道实现视频数据和控制的整合可减小互连线尺寸和重量，并简化系统设计。通过使用低电压差分信号、数据换序、SSCG 和随机生成更大限度减少了 EMI。在向后兼容模式下，该器件通过单/双链路支持高达 720p 和 1080p 的分辨率以及 24 位色深，并且在与支持 HDCP 的解串器配合使用时支持 HDCP v1.4。

封装信息

器件型号	封装(1)	封装尺寸(2)
DS90UH983-Q1	RTD（VQFN，64）	9mm × 9mm

(1) 如需了解所有可用封装，请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
(2) 封装尺寸（长 × 宽）为标称值，并包括引脚（如适用）。



简化版应用示意图

本资源的原文使用英文撰写。为方便起见，TI 提供了译文；由于翻译过程中可能使用了自动化工具，TI 不保证译文的准确性。为确认准确性，请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本（控制文档）。

Table of Contents

1 特性 1
2 应用 1
3 说明 1
4 Device and Documentation Support 3
4.1 Documentation Support 3
4.2 接收文档更新通知 3
4.3 支持资源 3
4.4 Trademarks 3
4.5 静电放电警告 3
4.6 术语表 3
5 Revision History 3
6 Mechanical, Packaging, and Orderable Information 4

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

4 Device and Documentation Support

4.1 Documentation Support

4.1.1 Related Documentation

For related documentation see the following:

- Texas Instruments, *Soldering Specifications* application note
- Texas Instruments, *Semiconductor and IC Package Thermal Metrics* application note
- Texas Instruments, *Leadless Leadframe Package (LLP)* application note
- Texas Instruments, *LVDS Owner's Manual*
- Texas Instruments, *I2C Communication Over FPD-Link III with Bidirectional Control Channel* application note
- Texas Instruments, *Exploring the Internal Test Pattern Generation Feature of 720p FPD-Link III Devices* application note
- Texas Instruments, *I2C Bus Pullup Resistor Calculation* application note
- Texas Instruments FPD-Link Learning Center, *FPD-Link Fundamental Material* video series
- Texas Instruments, *Ten tips for successfully designing with automotive EMC/EMI requirements*
- Texas Instruments, *Serial Line-Fault Detection* (Contact TI)

4.2 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 ti.com 上的器件产品文件夹。点击*通知* 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

4.3 支持资源

TI E2E™ 中文支持论坛是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的使用条款。

4.4 Trademarks

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.
所有商标均为其各自所有者的财产。

4.5 静电放电警告

静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

4.6 术语表

TI 术语表　　本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

5 Revision History

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

DATE	REVISION	NOTES
February 2024	*	Initial Release

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

6 Mechanical, Packaging, and Orderable Information

The following pages include mechanical, packaging, and orderable information. This information is the most current data available for the designated devices. This data is subject to change without notice and revision of this document. For browser-based versions of this data sheet, refer to the left-hand navigation.

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package | Pins	Package qty | Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
DS90UH983RTDRQ1	Active	Production	VQFN (RTD) | 64	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAUAG	Level-3-260C-168 HR	-40 to 105	UH983
DS90UH983RTDRQ1.A	Active	Production	VQFN (RTD) | 64	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAUAG	Level-3-260C-168 HR	-40 to 105	UH983
DS90UH983RTDTQ1	Active	Production	VQFN (RTD) | 64	250 | SMALL T&R	Yes	Call TI | Nipdauag	Level-3-260C-168 HR	-40 to 105	UH983
DS90UH983RTDTQ1.A	Active	Production	VQFN (RTD) | 64	250 | SMALL T&R	Yes	Call TI	Level-3-260C-168 HR	-40 to 105	UH983

(1) **Status:** For more details on status, see our product life cycle.

(2) **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

(3) **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the TI RoHS Statement for additional information and value definition.

(4) **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

(5) **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

(6) **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

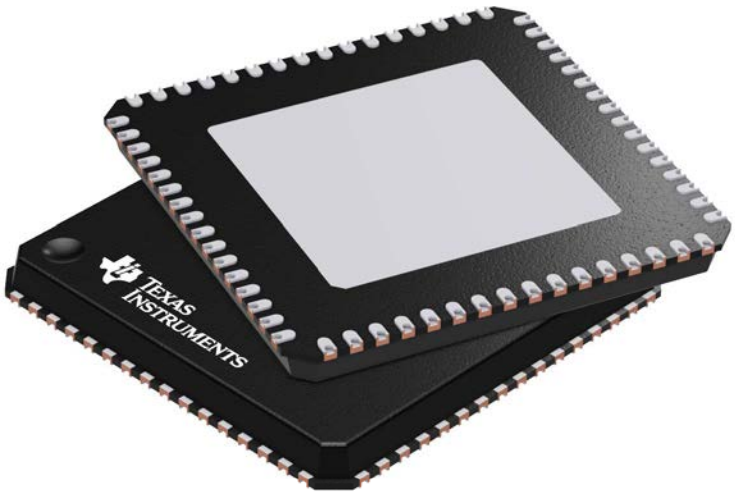
Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

GENERIC PACKAGE VIEW

RTD 64 VQFNP - 0.9 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



Images above are just a representation of the package family, actual package may vary.
Refer to the product data sheet for package details.

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，您将全额赔偿，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 TI 销售条款)、TI 通用质量指南 或 ti.com 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。 除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品，否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

版权所有 © 2026，德州仪器 (TI) 公司

最后更新日期：2025 年 10 月